

mitsubishi electric corporation

PUBLIC RELATIONS DIVISION

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan

PARA LANÇAMENTO IMEDIATO

N.º 3305

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência.

Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Questões de clientes

Information Technology R&D Center
Mitsubishi Electric Corporation
www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form.html
www.MitsubishiElectric.com/company/rd/

Questões da imprensa

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
www.MitsubishiElectric.com/news/

Mitsubishi Electric desenvolve chip de transmissão de banda ultralarga para sistemas sem fios multifuncionais

Tóquio, 26 de setembro de 2019 – A [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu o primeiro* chip de transmissão de banda ultralarga do mundo com capacidade de bandas S, C e X, concebido para sistemas sem fios multifuncionais. Espera-se que o novo chip facilite a redução do tamanho dos módulos de transmissão e aumente o alcance de transmissão dos sistemas sem fios. Os detalhes técnicos serão apresentados durante a Conferência Europeia de Micro-ondas/Conferência Europeia de Circuitos Integrados de Micro-ondas (EuMC, European Microwave Conference/EuMIC, European Microwave Integrated Circuits Conference) de 2019, com início a 29 de setembro, em Paris, França.

* De acordo com a pesquisa da Mitsubishi Electric, à data de 26 de setembro de 2019

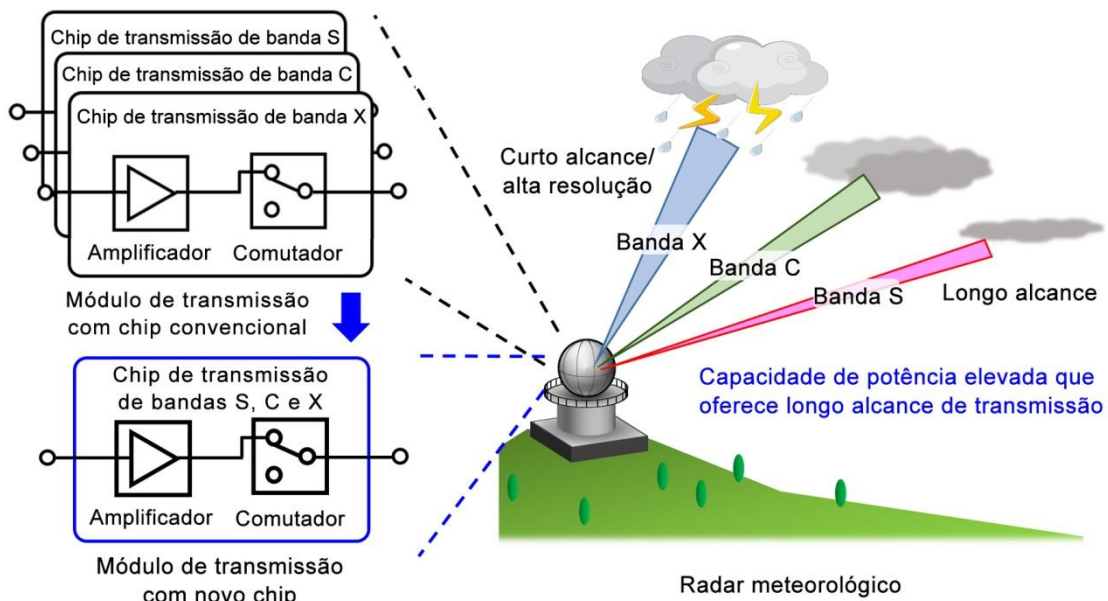


Fig. 1 Sistema sem fios multifunções que utiliza o chip de banda ultralarga

Principais funcionalidades

1) Nova configuração do amplificador que oferece características de banda larga

- O amplificador incorporado no novo chip está configurado em duas fases discretas: um amplificador de primeira fase distribuído e um amplificador de segunda fase com correspondência reativa combinam-se para fornecer capacidades de banda ultralarga.
- Um novo chip constituído por um amplificador e um comutador que cobrem uma largura de banda fracionada de 125% nas bandas S, C e X permite a redução do tamanho dos módulos de transmissão.

2) Design partilhado dos dois chips proporciona uma potência de saída elevada

- Os chips foram concebidos para reduzirem a perda de reflexão quando estão ligados entre si. Este design partilhado permite uma potência de saída elevada, mantendo as características da banda larga.
- O chip atinge uma potência de saída superior a 20 watts como módulo de transmissão, um desempenho elevado que satisfaz a necessidade de frequências de transmissão de banda larga dos sistemas sem fios.

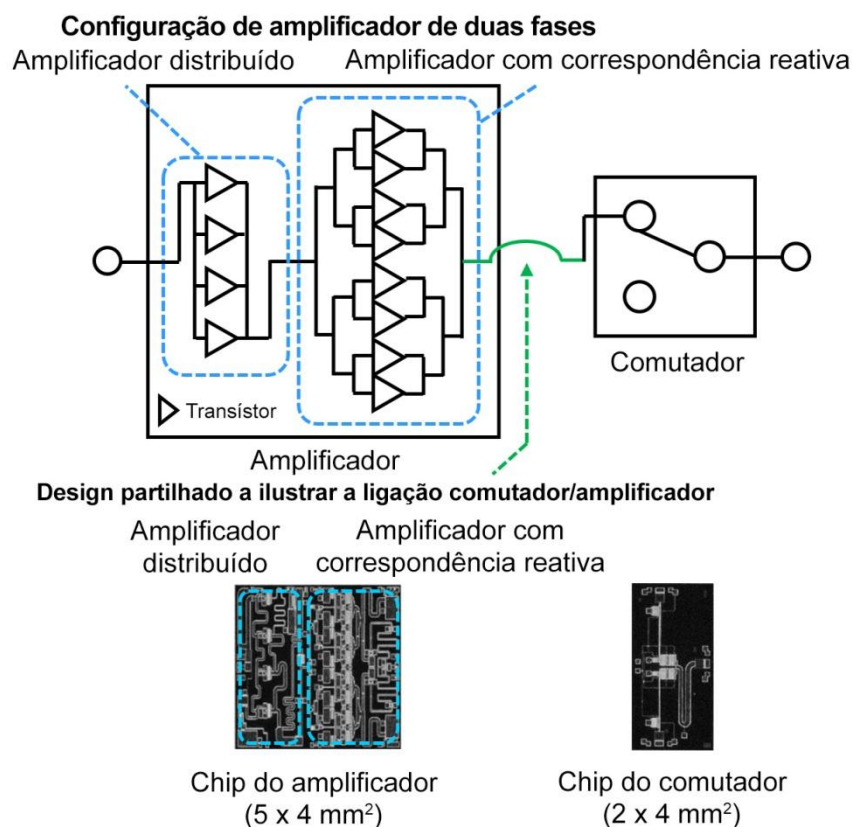


Fig. 2 Características do chip de transmissão de banda ultralarga

Desempenho

	Largura de banda fracionada	Potência de saída
Chip novo	125%	20 W
Chips convencionais	55%	20 W

###

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com quase 100 anos de experiência no fornecimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido na produção, marketing e venda de equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de informação, exploração espacial e comunicações por satélite, equipamento eletrónico, tecnologia industrial, equipamento de construção, energia e transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou um rendimento de 4519,9 mil milhões de ienes (40,7 mil milhões de dólares*), no ano fiscal que terminou a 31 de março de 2019. Para mais informações:

www.MitsubishiElectric.com

*A uma taxa de câmbio de 111 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio de Tóquio a 31 de março de 2019